

(51)Int.Cl.<sup>4</sup>H01S 3/18  
G02B 6/42

識別記号

F I

H01S 3/18  
G02B 6/42

審査請求 未請求 請求項の数29 OL (全11頁)

(21)出願番号 特願平8-280479

(22)出願日 平成8年(1996)10月23日

(71)出願人 000005843

松下電子工業株式会社

大阪府高槻市幸町1番1号

(72)発明者 永井 秀男

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業  
株式会社内

(72)発明者 中西 秀行

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業  
株式会社内

(72)発明者 油利 正昭

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業  
株式会社内

(74)代理人 弁理士 遠本 智之 (外1名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】光伝送モジュール

(57)【要約】

【課題】 LANなどのデータ伝送に用いる光伝送モジュールが、半導体レーザ光の出射方向と受光素子の受光方向とが実装面に対して90°異なるため、組み立てが複雑になり、かつ小型化するのが困難であった。

【解決手段】 半導体レーザ18の台座25となるSi基板に(111)面を利用した反射ミラー20を形成して半導体レーザ光19を台座の実装面に対して垂直に出射することにより、半導体レーザ18、駆動回路26、受光素子24、電流-電圧変換回路28等を同一パッケージ30に平面実装し、光ファイバー16、17が接続されたレンズ部で封止する。

